

前回レポート

センサエキスポジャパン2018

会期：2018年9月26日(水)～28日(金)
場所：東京ビッグサイト 東5ホール

出展者：※社名は当時のもの

アース(株)	/ Parlylene Japan
(株) アイテク	Smartec, Inc.
(株) アキュレイト / (株) オーギヤ	セイコー NPC(株)
(株) 旭ブリッジジョン	(株) 青電舎<東京大学発ベンチャー>
(株) アドバンストテクノロジー	センシリオ(株)
アフォードセンス(株) <兵庫県立大学発ベンチャー>	センシング技術応用研究会
(株) アブストス	/ (地独) 大阪産業技術研究所
(株) イージーメジャー	ソナス(株) <東京大学発ベンチャー>
(株) 五鈴精工硝子	Taiwan Silicon Microelectronics Corp.
イノベーションリサーチ(株)	／オート興産(株)
INNOZE Co., Ltd.	椿本興業(株)
(一財) 宇宙システム開発利用推進機構	(株) ディジ・テック
Aerotech(株)	東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 三林研究室
エヌエスティ・グローバリスト(株)	(一社) 東京科学機器協会
(株) エヌエフ回路設計ブロック	東京大学 IRT 研究機構
エフ・アイ・ティー・パシフィック(株)	東北大学大学院医工学研究科 芳賀・松永・鶴岡研究室
(株) MKTタイセー	(株) トーキン
(有) エムティプレシジョン	トピー・テクノロジー(株)
LS Cable & System Ltd.	(大) 長崎大学 山本郁夫研究室
オスマム・オプト セミコンダクターズ	NISSHA(株)
／ネクスティ エレクトロニクス	ニッタ(株)
科学情報出版(株)	日本電波工業(株)
(地独) 神奈川県立産業技術総合研究所	ノリタケ伊勢電子(株)
Gichoビジネスコミュニケーションズ(株)	(株) ハイテック・システムズ
(株) 金剛社	(株) ハギテック
Quanergy	伯東(株)
熊本大学CAST	(株) ヒキフネ
(株) グローワイル	フジカラ技研(株)
グローバル電子(株)	フェイス(株)
／ガス センシング ソリューションズ	(株) フジキン
／メリットセンサ	藤倉ゴム工業(株)
ケイエルブイ(株)	(一財) マイクロマシンセンター
KOA(株)	丸文(株)
興国インテック(株)	三井化学(株) / 三井化学東セロ(株)
コーニステクノロジー(株)	緑屋電気(株)
サンテス(株)	山下マテリアル(株)
(株) ジェイエクテクト	(株) 山本電機製作所
(一社) 次世代センサ協議会	横河電機(株)
新光電子(株)	(株) レーザー計測
Specialty Coating Systems	ロード・ジャパン・インク

併催企画：

●次世代センサフォーラム 主催：[一社] 次世代センサ協議会

►展示コーナー 出展者：

アフォードセンス株式会社 <兵庫県立大学発ベンチャー>	世界初のウェアラブル生活リズム計測センサ。一つのセンサを貼るだけで、行動推定と同時に心電、心拍、呼吸、緊張度、深部体温計測が可能。
東北大学大学院医工学研究科 芳賀・松永・鶴岡研究室	微細加工技術を用いた次世代医療・ヘルスケアデバイス
株式会社青電舎 <東京大学発ベンチャー>	形状記憶合金を用いた触感デバイスおよび新原理の高信頼性トルク計
地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所	KISTEC(神奈川県立産業技術総合研究所)のセンサー、微細加工等に関する事業内容、技術開発支援の紹介
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 三林研究室	(1) 生体成分モニタリング用「キャビタスセンサ」 (2) 生体触媒を利用して揮発性ガスセンサ「バイオスニフア」、可視化計測システム (3) 環境医学のための免疫計測システム
国立大学法人長崎大学 山本郁夫研究室	上肢リハビリロボットの開発
東京大学 IRT 研究機構	カンチレバ型気圧センサを用いた高度計
ソナス株式会社 <東京大学発ベンチャー>	ルーティングレスマルチホップ無線“Choco”を用いたセンシングソリューション

●技術発表コーナー

9月26日(水)	無機材料を対象としたインプリント金型の開発	地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
	電子線リソグラフィによる極微細パターン形成の紹介	地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
	IoTセンサ開発に向けた高周波解析評価技術	地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
	センシングの普及とこれからの社会	一般社団法人 次世代センサ協議会
世界初の深部体温計測が可能なウェアラブル生体センサの紹介		アフォードセンス株式会社 <兵庫県立大学発ベンチャー>
ルーティングレスマルチホップ無線“Choco”		ソナス株式会社 <東京大学発ベンチャー>
MEMS差圧センサを用いた小型・無線高度計		東京大学 IRT 研究機構
センシングの普及とこれからの社会		一般社団法人 次世代センサ協議会
非平面微細加工技術と低侵襲医療・ヘルスケアデバイスへの応用		東北大学大学院 医工学研究科 芳賀・松永・鶴岡研究室
形状記憶合金を用いたクリック感発生装置の原理と応用		株式会社青電舎 <東京大学発ベンチャー>
センシングの普及とこれからの社会		一般社団法人 次世代センサ協議会

お申込・お問合せ

フジサンケイ ビジネスアイ(日本工業新聞社) 営業・事業本部「センサエキスポジャパン」事務局
〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail: sensor@sankei.co.jp

IoTを実現する

センサ・コントロールとその応用技術、機器、システム、
ネットワークに関する専門展示会

SENSOR EXPO JAPAN

センサエキスポジャパン 2019

出展のご案内

9.11 W
13 F
10:00 - 17:00
東京ビッグサイト 南ホール

Fuji Sankei
Businessi.

フジサンケイ ビジネスアイ 営業・事業本部
「センサエキspoジャパン」事務局

〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2
TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail: sensor@sankei.co.jp

www.sensorexpojapan.com

開催概要

名 称	センサエキspoジャパン 2019 (SENSOR EXPO JAPAN 2019)
会 期	2019年9月11日(水)～13日(金) 10:00～17:00
会 場	東京ビッグサイト 南ホール
入場料	無料(事前登録または招待状持参の方)
主 催	フジサンケイビジネスアイ(日本工業新聞社)
特別協賛	[一社] 次世代センサ協議会

※後援・協賛等については関係省庁、団体へ申請し、決定し次第ホームページに掲載します。

出展対象

SENSOR EXPO JAPAN

センサエキspoジャパン 2019

▶出展例

センサ、ネットワーク、IoT、マイクロマシン・MEMS・NEMS、アクチュエータ、計測・制御・試験・検査分野の関連機器／装置／システム、部品・材料、電磁波・EMC・ノイズ対策、電池・電源、エネルギー、超電導、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボット、画像機器・産業用カメラ、ソフトウェア、その他関連製品・情報など

センシングに関する専門展示会です。センサ・コントロールとその応用技術、機器、システム、ネットワーク、情報が一堂に集結します。

来場対象

- ・センサや新たなセンシング技術を求めるあらゆる業種の研究開発者・技術者
- ・設計・製造、生産、品質管理・検査、購買・資材などに従事する専門家
- ・新たなセンサの活用を検討する流通・サービス業、小売業、農林水産業、交通・通信・エネルギーなどの社会インフラ、医療機関、政府機関の関係者など

同時開催

■ 测定計測展	主 催：日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会 特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ 測定・計測および光学・レーザに関する製品・技術・サービス・情報に関する展示会
■ TEST2019 (第15回 総合試験機器展)	主 催：日本試験機工業会 材料試験＆環境試験と計測、評価に関する国内唯一の総合展
■ 第21回 自動認識総合展	主 催：一般社団法人日本自動認識システム協会 バーコード、RFID、画像認識などの自動認識製品・技術とソリューションの専門展示会
■ 地盤技術フォーラム2019	主 催：一般社団法人土壤環境センター、フジサンケイ ビジネスアイ 地盤の見える化とその対策技術・製品・システムの展示会

開催までのスケジュール予定 (2019年)

5月17日(金)	出展募集締め切り (順次請求書を送付いたします)	9月 9日(月)	基礎装飾・出展者搬入(9:00～18:00)
7月	出展マニュアル、小間レイアウトなどの資料を 送付いたします	10日(火)	出展者搬入(9:00～18:00)
7月下旬以降	広報宣伝活動 (案内状発送、WEB更新、広告掲載など)	11日(水)	開場(10:00～17:00)
		12日(木)	開場(10:00～17:00)
		13日(金)	開場(10:00～17:00) 撤去・搬出(17:00～)
		11月末頃	報告書送付

出展要項

Aタイプ

▶出展小間規格

1小間=9m² (間口3m×奥行3m×高さ2.7m) 側壁・後壁のみ設置(角小間は側壁なし)

▶出展料

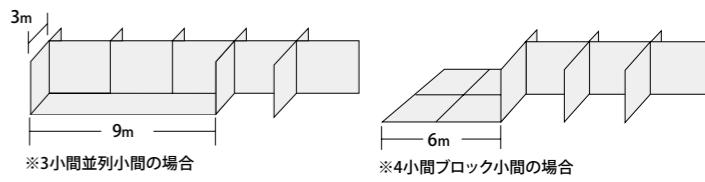
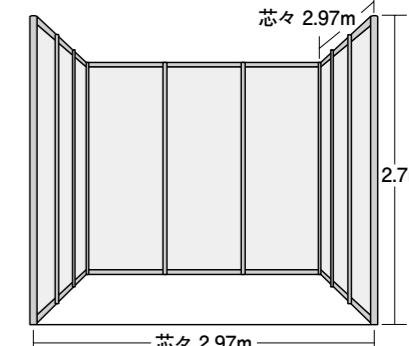
特別協賛の法人会員 1小間 310,000円(税別) 一般 1小間 370,000円(税別)

▶小間形態・装飾高さ制限

1～3小間 …並列小間のみ(高さ:4mまで使用可能)
※但し、1mセットバックした部分のみ)

4～5小間 …並列小間、プロック小間より選択可能
(高さ:4mまで使用可能) ※但し、並列小間は1mセットバック)

6小間以上 …原則プロック小間のみ(高さ:5mまで使用可能)
※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談下さい。



▶パッケージ装飾

※詳細・申込については、出展申込後にお送りする出展者マニュアルにてご案内いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

▶1小間タイプ (間口3m×奥行3m)

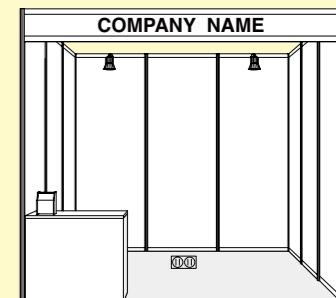
94,000円(税別)

社名板(パラペット)/社名表示(黒・ゴシック)/受付カウンター:1台(W900×D450×H800)/床面カーペット/電気(FL40W:1灯、SP100W:2灯)/折りたたみ椅子:1脚/名刺受け:1個/1KW以内の電気幹線工事費、使用料/コンセント:1個

▶2小間タイプ (間口6m×奥行3m)

164,000円(税別)

社名板(パラペット)/社名表示(黒・ゴシック)/受付カウンター:1台(W900×D450×H800)/床面カーペット/電気(FL40W:2灯、SP100W:4灯)/折りたたみ椅子:1脚/名刺受け:1個/1KW以内の電気幹線工事費、使用料/コンセント:1個
※3小間以上のタイプは事務局へお問い合わせください。



Bタイプ

1社1小間限定

▶出展小間規格

1小間=間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.7m 一定装飾付き(角小間は側壁なし)

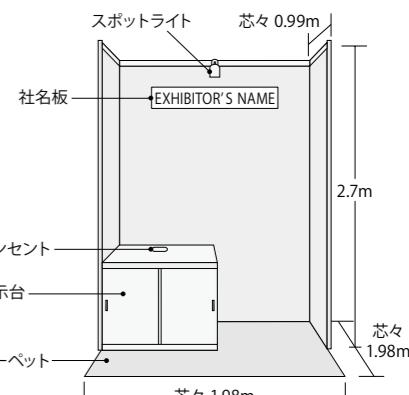
▶出展料

※出展料、簡易装飾込み

特別協賛の法人会員 1小間 190,000円(税別) 一般 1小間 210,000円(税別)

出展料に含まれるもの: 間口2.0m×奥行2.0mの展示スペース、間仕切り(後壁、側壁1m)、社名板、カーペット、展示台: 横幅1.0m×奥行1.0m×高さ0.8m、引き戸ユニット(鍵ナシ)、スポットライト: 22W×1、コンセント(アース付100V): 2個口×1,500Wまでの電気幹線工事費・電気使用料

※備品の追加注文がある場合は、別途ご請求させていただきます。詳しい資料は出展社説明会にてお渡しいたします。
※上記基本ディスプレイを使用しない場合も、料金を差引くことはできませんのでご了承ください。



▶製品・技術発表会

展示会場内の特設セミナースペースで開催する新技術・新製品PRセミナー

日 時: 2019年9月11日(水)～13日(金) 10:00～17:00 内で45分間

場 所: 展示会場内特設会場(シアター形式 80名定員)

発表料金: 1セッション 50,000円(税別)

運営方法: 1、聴講無料(各回総入替)

2、受付・進行は発表各社が担当(登録や名刺回収は自由です)

会場設備: 受付(机、イス)、聴講席、演台、マイクセット、プロジェクター、スクリーン

P R: 案内状、ホームページ等に社名・プログラムを掲載

⟨注⟩・申込書に20字以内でセミナータイトルを記載下さい。

・終了後は現状復帰をお願いいたします。

・PC使用の場合は各自お持込下さい。※接続テスト等はご相談下さい

・発表日時は主催者にて決定します。

▶ホームページ広告

貴社のリンクバナーを公式WEBに開催1か月前から掲載

日 時: 2019年8月5日(月)～9月13日(金) ※予定

場 所: W200px×H40px GIF形式 ※アニメーションGIF可

発表料金: 1枚 50,000円(税別)

原稿締切日: 2019年7月19日(金) ※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。